**[필독]**

**개인정보 수집 및 이용제공 동의서 내용을 수기로 작성後**

**스캔하시어 지원서에 본문 첨부제출 바랍니다.**

**지원자 개인정보 수집 및 이용 · 제공 동의서**

삼성전자주식회사(이하 "회사"라 함)는 개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 관련 법령상의 개인정보보호 규정을 준수하며, 응시자의 개인정보보호에 최선을 다하고 있습니다. 회사는 개인정보보호법 제 15조 및 제17조에 근거하여, 응시자로부터 개인정보를 수집 및 이용·제공하는데 필요한 동의를 받고자 합니다.

1. 개인정보의 수집항목 및 수집방법, 수집 및 이용목적, 보유 및 이용기간

 - 수집 항목 : 성명, 국적, 생년월일, 영문성명, 보훈정보, 장애정보, 주소, 전화번호, 핸드폰 번호, 학교,

 전공, 입학일, 졸업일, 성적, 학번, 지도교수명, 논문제목, 병역정보, 경력정보, 해외체류정보,

 사회활동정보, 해외연수정보, 자격증정보, 어학정보

 - 수집 방법 : 이메일

 - 수집 및 이용 목적 : 채용 전형

 - 보유 및 이용 기간 : 제출된 개인정보는 채용 결정되는 경우 재직기간 동안 보관되고,

 만약 채용되지 않는 것으로 결정되는 경우에도 인재채용을 위한 인재풀로 활용될

 예정으로, 지원자의 삭제 요청시까지 보관됩니다.

\*본인은 회사가 위와 같이 개인정보를 수집 및 이용하는 것을 충분히 이해하고 이에 동의합니다. (예,아니오)

2. 개인 정보의 제 3자 제공 동의

 당사는 공정한 채용을 위해 학위 검증과 평판 조회를 실시합니다.

2.1. 학위 검증

 당사는 기재하신 학력의 진위여부를 확인하기 위해서, 아래와 같이 귀하의 개인정보를 제공합니다.

 - 제공대상 : 기재하신 학력에 해당되는 교육기관

 - 제공하는 개인정보 : 성명, 생년월일, 학력사항(학교명, 전공명, 입학년도, 졸업년도 등)

 - 개인정보 제공목적 : 학위 검증

 - 개인정보 보유 및 이용기간 : 정보제공 목적 달성 후 즉시 파기

2.2. 평판 조회(Reference Check)

 당사는 지원하신 분의 평판을 조회하기 위해서, 아래와 같이 지원자의 개인정보를 제공합니다.

 - 제공대상 : 커리어케어, 입사지원자가 근무한 경력이 있는 당사의 관계사

 - 제공하는 개인정보 : 성명, 생년월일, 경력사항(회사명, 부서명, 직책/직무, 입사년도, 퇴직년도 등)

 - 개인정보 제공목적 : 평판 조회

 - 개인정보 보유 및 이용기간 : 정보제공 목적 달성 후 즉시 파기

귀하께서는 귀하의 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부하실 권리가 있습니다. 하지만 개인정보 수집 및 이용에 대해 동의를 거부하실 경우 당사 채용 전형이 진행되지 않을 수 있습니다.

\* 본인은 회사가 위와 같이 개인정보를 제 3자에게 제공하는 것을 충분히 이해하고 이에 동의합니다.(예,아니오)

20 년 월 일 성명 : (인 또는 성명)





 작성일: 20\_\_. \_\_. \_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **인****적****사****항** | **성명** |  | **영문성명** |  |
| **생년월일** | 000000 | **검토희망사업부** | 1지망 :2지망 :3지망 : |
| **핸드폰** |  | **희망****지원분야** | 1지망 :2지망 :3지망 : |
| **e-mail** |  |
| **주 소** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **학****력****사****항** | **구 분** | **입학년월** | **졸업년월** | **학교명** | **전공** | **졸업구분** | **소재지** |
| **고등학교** | YYYY.MM | YYYY.MM |   |  |  |  |
| **대학교** | YYYY.MM | YYYY.MM |  |  |  |  |
| **대학교****(석사)** | YYYY.MM | YYYY.MM |  |  |  |  |
| 졸업논문 |  |
| LAB. |  |
| **대학원****(박사)** | YYYY.MM | YYYY.MM |  |  |  |  |
| 졸업논문 |  |
| LAB. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **경****력****사****항** | **근무기간** | **근무처** | **직위** | **직무** |
| YYYY.MM ~ YYYY.MM |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **자격****사****항** | **특수자격및면허** | **등급** |  | **어****학****사****항** | **영어** | 점(응시명) |  | **특****기****사****항** | **병역구분** | 필/미필/면제 |
|  |  | **일어** |  | **면제사유** |  |
|  |  | **중국어** |  | **군별** |  |
|  |  | **기타** |  | **보훈여부** | ( Y / N ) |

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **지원기관명** | **연구 기간** | **연구 제목** |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **지원기관명** | **연구 기간** | **연구 제목** |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **지원기관명** | **연구 기간** | **연구 제목** |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **지원기관명** | **연구 기간** | **연구 제목** |
|  |  |  |
|  |

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회사명** | **근무 기간** | **주요 업무** |
|  | ~ |  |
| (보유 기술분야 및 수행내역 상세 기술)  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회사명** | **근무 기간** | **주요 업무** |
|  | ~ |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회사명** | **근무 기간** | **주요 업무** |
|  | ~ |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회사명** | **근무 기간** | **주요 업무** |
|  | ~ |  |
|  |

**연구실적 목록 (SCI(E))**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **구분** | **Title** | **Journal** | **Author** | **비고** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |

**연구실적 목록 (국내학술지)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **구분** | **Title** | **Journal** | **Author** | **비고** |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |

**연구실적 목록 (국제학술대회)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **구분** | **Title** | **Conference** | **Author** | **비고** |
| **12** |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |
| **16** |  |  |  |  |  |

**연구실적 목록 (특허)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **구분** | **발명의 명칭** | **특허번호** | **발명자** | **비고** |
| **17** |  |  |  |  |  |
| **18** |  |  |  |  |  |
| **19** |  |  |  |  |  |
| **20** |  |  |  |  |  |
| **21** |  |  |  |  |  |
| **22** |  |  |  |  |  |
| **23** |  |  |  |  |  |

**연구실적 목록 (국내학술대회) – 00편 발표**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **대인관계** |  |
|  |
| **장점과 단점** |  |
|   |
| **학생시절/사회생활** |  |
|  |
| **입사 후 포부** |  |
|   |